



EV GROUP Leads Advanced Optical Lithography with Next-Generation EVG150 Resist Processing Platform – November 7, 2022

EV GROUP、次世代の EVG150 レジスト処理プラットフォームで先端光リソグラフィをけん引
EV Group

From: 共同通信PRワイヤー

2022-11-08 12:44

- [その先のセキュリティへ！ゼロトラスト・エッジというアプローチ](#)
- [導入事例、製品情報、調査・レポートなど、ホワイトペーパー多数掲載](#)

AsiaNet 98670

EV GROUP、次世代の EVG150 レジスト処理プラットフォームで先端光リソグラフィをけん引

業界をリードする前世代の性能を維持しつつ、200mm基板向けプラットフォームを再設計

モジュール容量の増加によるスループットの向上、装置フットプリントの縮小を実現

オーストリア ザンクト・フローリアン, 2022年11月8日 /PRNewswire / -- MEMS、ナノテクノロジーデバイス、半導体製造向けウェーハ接合およびリソグラフィ装置のリーディングサプライヤーであるEV Group（以下、EVG）は本日、200 mm 基板対応の次世代EVG（R）150全自動レジストプロセス装置を発表し、光リソグラフィソリューションのポートフォリオを強化したことを発表しました。新しいプラットフォームとして設計されたEVG150は、前世代と比べて、スループットを高める（最大 80%）だけでなく汎用性をさらに向上させ、装置フットプリントも約50%に縮小させるなど、先端機能の追加と更なる機能の拡張を実現しています。最先端パッケージング、MEMS、高周波（RF）、3Dセンシング、パワーエレクトロニクス、フォトニクスなど、さまざまなデバイスやアプリケーションをサポートするユニバーサルプラットフォームであるEVG150は、高い信頼性で高品質の塗布/現像プロセスを提供します。高いスループット、柔軟性、再現性で大量生産と産業向け開発用途の両方における最も厳しいニーズに応えます。

写真 - ([リンク](#) »)

写真 - ([リンク](#) »)

ロゴ - ([リンク](#) »)

11月15日から18日までドイツのミュンヘンにあるメッセ ミュンヘンで開催される SEMICON Europa（Electronica と共同開催）において、当社執行役員が、この次世代の EVG150 レジストプロセス装置についてご案内します。ご希望の方は、EVGブース #C1211までお越しください。

次世代装置であるEVG150を導入する最初の顧客となるのは、EBS（Electronic Based Systems）の主要研究機関であるSilicon Austria Labs（シリコン・オーストリア・ラボ）です。Silicon Austria Labsのマイクロシステム研究部門責任者であるDr. Mohssen Moridi は、次のように述べています。「当ラボは、大手メーカーとの共同研究を通じて、インダストリー4.0、IoT、自動運転、サイバーフィジカルシステム（CPS）、AI、スマートシティ、スマートエネルギー、スマートヘルスの基盤を構築する主要な技術を、これらが市場に出るずっと前の段階から開発を進めています。」「EVGの次世代レジストプロセス装置EVG150はその高い柔軟性で、EBSの技術革新を促進するために研究を進める我々の顧客とともに、新

たなプロセスの確立と製品量産化の実現へと導きます。」

これまでにない柔軟性を実現したユニバーサルプラットフォーム

200mm基板対応の次世代EVG150は、前世代の全自動プラットフォームが持つ業界最高水準の性能をそのままに、スピン/スプレー塗布、現像、ベーク/冷却用のカスタマイズ可能なモジュール構成、さらには極端な段差にも対応するEVG独自のOmniSpray (R) テクノロジー、ウェーハエッジ・反り・ゆがみ・薄ウェーハなどの搬送でも高スループットを実現するデュアル・エンドエフェクター機能による現場で実証済みの高度なロボットハンドリング、などの機能の進化を遂げました。

次世代EVG150 200mm プラットフォームの新機能は次のとおりです：

* 最大4台のウェット処理モジュールスペースと最大20台のベーク/冷却ユニットを備え、より多くのウェーハの同時処理が可能。

* モジュール間を完全に分離。モジュール間のクロスコンタミネーションを排除するために個別化された塗布チャンバー。

* 外側から個々のチャンバーにアクセスできるようモジュール構造を再設計。チャンバーのメンテナンスのために発生する装置ダウンタイムを短縮。

* プラットフォーム内のチャンバーレイアウトを変更。ロボット搬送ユニットへのアクセスがしやすく、メンテナンスが容易に。

* 高速処理対応ウェーハプリアライメント。リアルタイムでウェーハ中心位置合わせを実現する画像処理によるプリアライナー。

* レジスト/薬液ラインを装置内に統合することで、薬液キャビネット用外部スペースを削減し、装置フットプリントを縮小。

* 装置内のユーザーインターフェース統合により、さらに装置フットプリントを縮小。

EVGのコーポレート・テクノロジー・ディレクターであるDr.トーマス・グリンズナーは以下のように述べています。「レジスト処理とパターニングは、半導体製造工程の中で最も繰り返されるプロセスです。EVGは、光リソグラフィ、スピン/スプレー塗布など、これらのプロセスで長年にわたり経験を積み、最も要件の厳しい顧客のニーズに応えてきました。」「これらの経験から学んできた知見を存分に反映させたのが、この私たちの次世代EVG150です。スループットと所有コストを飛躍的に向上させ、多様なレジスト処理のニーズに柔軟に対応するユニバーサルプラットフォームとしてゼロから設計を見直しました。」

製品のご購入について

EVGは、新たに発表された次世代EVG (R) 150全自動レジストプロセス装置の受注を開始しています。また、オーストリア本社にて製品のデモンストレーションも承っております。詳細については、こちらをご覧ください。

[\(リンク »\)](#)

EV GROUP (EVG) について

EV Group (EVG) は半導体、MEMS、化合物半導体、パワーデバイスおよびナノテクノロジーデバイスの製造装置およびプロセスソリューションのリーディングサプライヤーです。主要製品には、ウェーハ接合、薄ウェーハプロセス、リソグラフィ/ナノインプリント・リソグラフィ (NIL) や計測機器だけでなく、フォトレジストコーター、クリーナー、検査装置などがあります。1980年に設立されたEVGは、グローバルなお客様および世界中のパートナーに対し緻密なネットワークでサービスとサポートを提供

します。EVGに関する詳しい情報は ([リンク](#) ») をご参照ください。

お問い合わせ先：

イーヴィグループジャパン株式会社 マーケティング担当

TEL: 045-348-0665 E-mail: Marketing+CommunicationsJapan@EVGroup.com

<mailto:Marketing+CommunicationsJapan@EVGroup.com>

▽報道関係お問い合わせ先

Contacts:

Clemens Schütte

Director, Marketing and Communications

EV Group

Tel: +43 7712 5311 0 E-mail: Marketing@EVGroup.com <mailto:Marketing@EVGroup.com>

David Moreno

Principal

Open Sky Communications

Tel: +1.415.519.3915 E-mail: dmoreno@openskypr.com <mailto:dmoreno@openskypr.com>

<https://japan.zdnet.com/release/30799102/>